QQ:857046846 购买独立主板 (从流程4开始) 适用 XDriveBL F1.1 IVES Lab (艾维斯实验室) 购买完整套装(从流程8开始) 适用 XDriveAPP F1.1.5 QQ:557214000 XDrive探索流程 1. 制作PCB 2. 购买元器件 3. 焊接电路版 使用GERBER文件 根据BOM文件 根据焊接图 去喜欢的板厂做板子 去喜欢的平台购买物料 用喜欢的方式展示元器件位置 文件目录: (Hardware) 文件目录: (Hardware) 文件目录: (Hardware) XDrive_gerber.rar XDrive_welding_top.pdf XDrive_welding_bottom.pdf $XDrive_bom.xlsx$ 6. 焊接电机线 5. 安装PCB PCB传感器与电机轴同心 根据PCB 线圈焊盘定义 将磁铁安装在步进电机尾端 将电机线焊接在PCB上 传感器表面磁场强度<1000mT 磁铁需使用径向磁铁 *若后续发现电机旋转方向与需要的相反 传感器与磁铁尽量靠近 可以调换(A+ A-)或调换(B+ B-)修改方向 磁铁需要与电机轴同心 常规安装间隙为1mm~2.5mm 7. 烧写引导 8. 编译APP 使用全新XDrive APP工程 仅使用USB将PCB连接电脑和XDrive 将"xdrive bl.bin"通过SWD接口 烧写到单片机Flash (0x08000000) OLED显示"XDriveBL f11" 编译生成"xdrive app.bin" 文件目录: (Firmware_BL) 等待电脑成功驱动在设备和驱动 显示"XDriveBLf11"盘, xdrive_bl.bin 将"xdrive_app.bin"拖入 等待完成APP的更新 OLED开始显示"XDrive"软件界面 完成APP烧写 *APP也可以直接使用SWD烧入 12. 首次校准 11. 正常启动 10. UI逻辑 界面逻辑文件: 进入校准界面 仅使用PH2.0接口电源启动XDrive Specification/UI Loogic.png 键入"确定"启动校准 启动过程不要按下按键 按键逻辑文件 电机会正反旋转校准 Specification/Button.png 校准结果在OLED上显示 13. 重新上电 14. 模式测试 15. 定制APP 仅使用PH2.0接口电源启动XDrive 在XDrive支持的模式中选择测试 根据使用需求修改APP程序配置 重新编译生成 "xdrive_app.bin" 根据模式调整跳线帽 *在内测时,许多用户无响应由该问题造成 1. 断开XDrive所有接线 2. 按下任意按键 在PH2.0输入接口传入对应型号 3.使用USB连接电脑和XDrive 将更新的"xdrive_app.bin 拖入XDriveBL f11 XDrive 会不停优化以实现更多功能 欢迎开发者加入 联系方式: 联系上述群主 17. 正常使用 恭喜完成所有流程啦!!! 仅使用PH2.0接口电源启动XDrive 启动完成后将以定制的固件配置运行

适用 XDrive H1.1

By REIN Lab (知驭实验室)

完全DIY (从流程1开始)